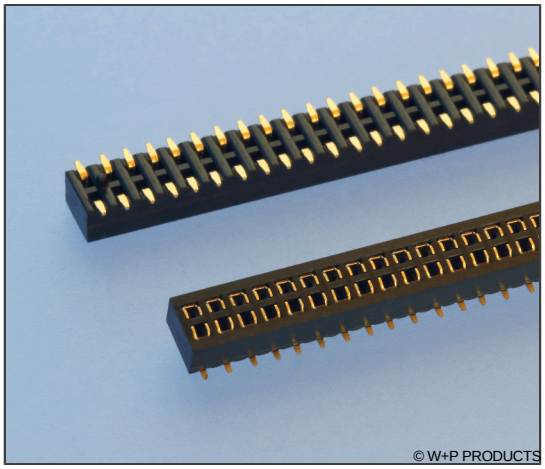
46-6061

SMT-Buchsenleisten RM 1,27mm, stehend, 2-reihig – BH 2,15mm, von unten steckbar

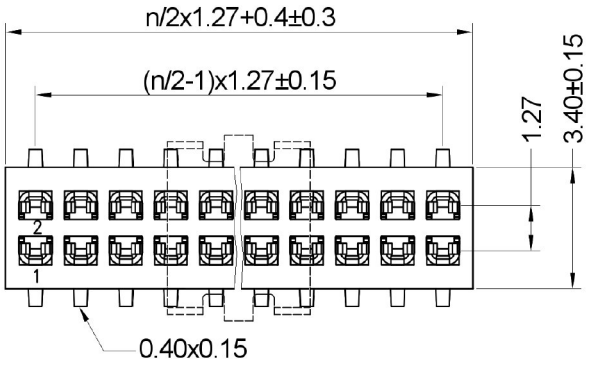
SMT Female Headers, 1.27mm Pitch, Vertical, Double Row – 2.15mm, Bottom Entry

Technische Daten / *Technical Data*

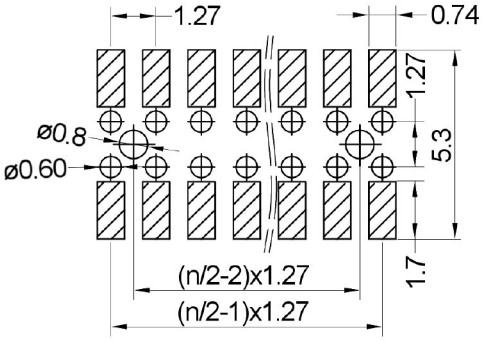
Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	*Thermoplastic, rated UL94 V-0*
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	*Copper alloy*
Kontaktoberfläche	Au über Ni
Contact Surface	*Au over Ni*
RoHS-Ausnahmen 6a-I / 6c	keine
RoHS Exemptions 6a-I / 6c	*none*
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	*< 20 mΩ*
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	*> 1000 MΩ*
Spannungsfestigkeit	500 V AC/DC
Withstanding Voltage	*500 V AC/DC*
Nennstrom	1 A
Current Rating	*1 A*
Temperaturbereich	-40 °C ~ +105 °C
Temperature Range	*-40 °C ~ +105 °C*
Verarbeitung	260 °C für 10 sec. / 230 °C für 30~60 sec.
Processing	*260 °C for 10 sec. / 230 °C for 30~60 sec.*

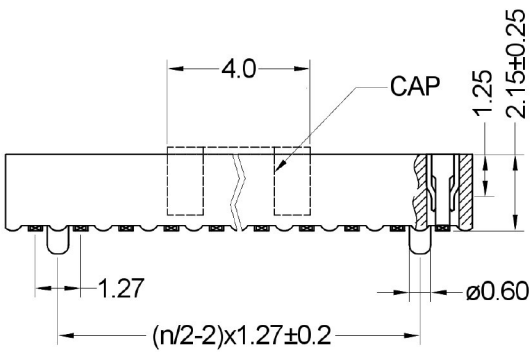


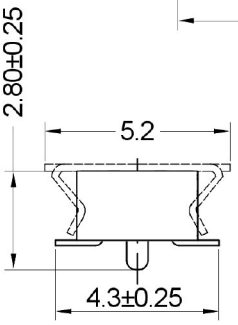
Geeignet für 0,40mm Vierkantstifte
Mates with 0.40mm square pins



Recommended P.C.B Layout(Top Side)
(PCB BOARD TOLERANCE±0.05)







Series	***Contacts****	***Plating***	***Locating Pegs****	***Packaging****
46-6061	**022**	**00**	**10**	**MPST**
	006-080 Zweireihig *Double row*	**00** Vergoldet *Gold plated*	**00** Ohne Pos. hilfen *W/o loc. pegs* **10** Mit Pos. hilfen *With loc. pegs*	**ST** **MPST** **MPTR**

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
** This is an **order example** -*
please replace by your specifications.

Lieferformen / *Packaging Options:*
ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads / *In tubes w/o Pick&Place-Pads*
MPST In Stangen mit Metall-P&P-Pads / *In tubes with metal P&P-Pads*
MPTR Tape & Reel mit Metall-P&P-Pads / *Tape & Reel with metal P&P-Pads*

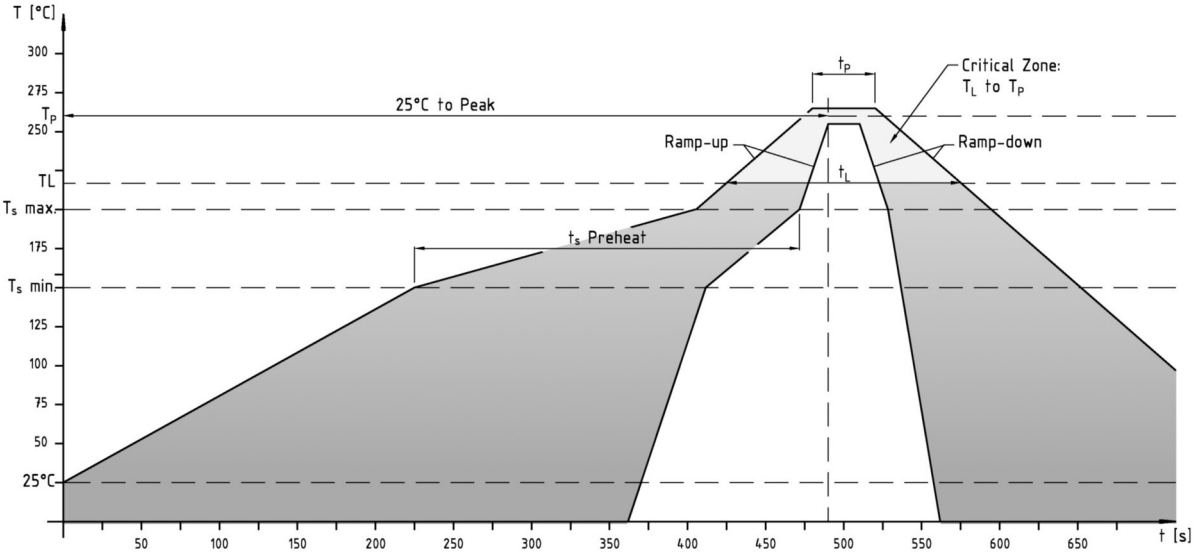
Reflow-Lötverfahren
Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_S$min	150 °C
Temperatur Maximum $T_S$max	200 °C
Dauer $T_S$min – $T_S$max	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	untere Temperaturangabe [°C]
Verweildauer oberhalb T_L	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	obere Temperaturangabe [°C]
Dauer Höchsttemperatur	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_S$min	*150 °C*
Maximum Temperatur $T_S$max	*200 °C*
Duration $T_S$min – $T_S$max	*60 – 180s*
Soldering Range Temperature T_L	*Lower Temperature [°C]*
Duration above T_L	*Acc. to datasheet [sec]*
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	*max. 3 °C / s*
Peak Temperature T_P	*Upper Temperature [°C]*
Duration Peak Temperature	*Acc. to datasheet [sec]*
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	*6 °C / s*
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	*max. 8min*